

&gt;&gt;&gt;&gt;...

## 智能机五年内飞速发展 改写全球手机芯片格局

我爱研发网2月27日消息，据eettaiwan报道，根据市场研究公司IHS iSuppli的报告显示，智能手机在过去五年来的巨大销售成长，再加上 4G LTE 崛起，明显改写了全球手机芯片市场的竞争格局——高通(Qualcomm)与三星(Samsung)两家供应商分别位居全球第一与第二。

IHS表示，高通自2007年以来一直在基带与RF芯片等特定手机芯片市场占据主导地位。去年，高通在全球手机核心芯片营收的市场占有率已达到了31%，较2007年时的23%更显著成长。

而三星的崛起或许还更令人印象深刻。2007年时，这家韩国巨擘甚至还不在于手机IC销售的前10大排名。而到了去年，IHS指出，三星已经快速成长到全球排名的第二大，在整体手机核心芯片营收占21%。

根据IHS表示，高通与三星两家公司就占了整个市场一半以上的占有率，而接下来的8家芯片供应商合计约占34%的手机核心芯片销售。整体来看，排名全球前十大的手机芯片供应商共占总销售的86%。

Rank	Company	2007	2012*
1	Qualcomm	23%	31%
2	Samsung Electronics	N/A	21%
3	MediaTek	6%	9%
4	Intel	N/A	6%
5	Skyworks Solutions	3%	4%
6	Texas Instruments	20%	4%
7	ST-Ericsson	6%	4%
8	Renesas Electronics	4%	3%
9	Spreadtrum Communications	N/A	3%
10	Broadcom	N/A	2%
	Others	39%	14%
	Total	100%	100%

\*2012 consists of Q1-Q3 revenue and estimated Q4 revenue

Source: IHS iSuppli Research, February 2013

2012年全球前十大手机核心芯片供应商排名(根据总营收计算市场占有率)

IHS消费与通讯市场分析师Brad Shaffer指出，智能手机与 4G LTE 的崛起，造就了“典范的转型”，改变移动手机核心芯片的市场竞争格局。

“五年前苹果公司推出 iPhone 后，改变了这一市场游戏规则，也为现有的市场排名而铺路，” Shaffer说，“这个变化可从2007-2012年间手机核心芯片排名出现的明显差异看出端倪。从这一市场方向

转变而受益的公司排名提升至主导地位，而其它供应商则因变动的市场环境而受限制或冲击。”

IHS定义的手机核心芯片包括为手机提供无线广域网(WWAN)以及应用处理功能的各种芯片。该市场领域包括各种针对类基带、数位基带、功率放大器、无线电与中频、高端作业系统与软体处理器以及其它多媒体或绘图处理器的手机核心芯片。

### 英特尔加入战局

根据IHS的报告，英特尔公司(Intel)在去年进入前十大手机芯片供应商之列，排名第四大供应商。英特尔得以抢进全球前十大，主要由于在2011年时收购了英飞凌科技(Infineon Technologies)的无线IC业务。IHS表示，英特尔已经开始关注采用 Atom 处理器的一些机会，以及致力于获得摩托罗拉与其它手机OEM的采用。

2012年还有两家供应商也闯进前十大——展讯通讯公司(Spreadtrum Communications; 排名第九)以及博通公司(Broadcom; 排名第十号)。根据IHS表示，从2007年至2012年的五年内，展讯的数位基带IC营收扩增了370%以上。同样地，博通也由于2011年取得更多基带芯片订单与营收，而迅速提升至第十名。

在2007年排名全球第二的德州仪器公司(TI)则在去年下滑至第六名。在2007年至2012年的五年内，随着TI开始淘汰其基带芯片产品，该公司的市场占有率也从20%下滑至4%。IHS表示，TI OMAP 应用处理器无法如预期地在智能手机市场取得成功，同时，TI在去年还宣布 OMAP 将专注于嵌入式领域。

IHS预测，移动手机核心IC市场的结构将持续转变，特别是 LTE 应用正变得越来越广泛之际。

基带芯片大约占整个手机核心芯片营收的一半以上；同时，在决定业界供应商的市场占有率得失与多寡时，基带芯片仍持续占据主导位置，IHS强调。此外，该公司并预测，未来还将取决于IC供应商能否提供可实现最佳化系统级设计的IC解决方案。

(来源: eettaiwan)